

证券代码：688689

证券简称：银河微电

**常州银河世纪微电子股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	银华基金郭磊 兴全基金涂围
<b>时间</b>	2021年6月23日
<b>地点</b>	电话会议
<b>公司接待人员姓名</b>	总经理岳廉 董事会秘书金银龙
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>Q：公司对业高景气度的持续性公司怎么看，目前公司的产能利用率、交期以及涨价情况如何？</p> <p>A：在当前半导体器件供不应求的竞争形势下，有效资源将更有利于向行业高景气度的公司集中，更有利于行业头部企业创新发展。我们预计高端器件的紧缺还会持续一段较长的时间。</p> <p>公司目前在手订单充足，生产经营情况正常，产能利用率较高，并积极推进募投扩产项目的实施，不断提升产能。</p> <p>在目前交期不得不延长的情况下，公司按照客户的需求紧急度、重要度以价格毛利情况等几个维度综合考量安排供货。</p> <p>由于原物料的大幅涨价，导致公司产品成本的上升，对此公司在产品销售方面也采取了相应的价格调整策略，以保证公司产品毛利率能维持在合理的水平。</p> <p>Q：公司的自研芯片情况，自研芯片的封装占比，供应商涨价的情况如何？</p> <p>A：公司拥有分立器件芯片研发生产线，自制芯片主要是部分品类的功率二极管芯片，包括高压整流二极管芯片、超低压降整流二极管芯片、瞬态电压抑制二极管芯片等平面结构二极管芯片，以及整流二极管芯片、超快恢复开关二极管芯片等台面结构二极管芯片，小信号器件和光电器件等品类产品的芯片目前全部外购。</p>

	<p>公司自制的芯片主要用于自配，很少对外销售，目前公司自制芯片约占公司芯片总需求的 20%-25%。</p> <p>去年以来，公司采购的各种原材料价格都有一定幅度的上涨，特别是芯片、铜材等涨幅较大，对产品的材料成本产生了较大的影响。公司通过规模化生产和加强成本管控消化了部分压力，同时也通过市场端销价调整转化了部分压力。</p> <p>Q: 公司产品下游应用的占比变化，在本轮缺货中是否带来加速导入高端客户的机会？</p> <p>A: 公司产品的下游应用主要为计算机及周边设备、家用电器、网络与通讯、适配器及电源、绿色照明、工业控制、汽车电子等领域，对各个应用领域的销售今年都呈现明显的同比上涨趋势，特别是计算机及周边设备应用领域的占比和同比增幅均较大，2021 年第一季度的占比达到 26.5%，同比增幅超过 110%。</p> <p>本轮缺货的确给公司带来了加速导入高端客户的机会，公司积极推进产品结构和客户结构的调整，加快针对重点客户的供应商资格认定、批量供货导入和品种份额提升等拓展工作，促进公司的长期可持续发展。</p> <p>Q: 公司产品升级以及品类扩充的战略构想及计划？</p> <p>A: 围绕公司的发展战略，公司近期将紧紧围绕两个募投项目：“半导体分立器件产业提升项目”和“研发中心提升项目”来展开。通过强化技术创新能力，不断提高产品性能和质量水平，适应小型化、功率化、集成化以及高能效、高可靠性的市场要求，努力实现公司经营业绩的稳长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 7 月 3 日

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰基金张阳
时间	2021 年 6 月 25 日
地点	常州银河世纪微电子股份有限公司会议室

<p><b>公司接待 人员姓名</b></p>	<p>董事长杨森茂 财务经理李福承</p>
<p><b>投资者关 系活动 主要内容 介绍</b></p>	<p>Q: 如何看待行业景气度的持续性 A: 就中长期而言, 新技术的发展和叠加, 使得信息化、智能化和自动化进程加快, 有力地拉动了半导体器件的需求; 就短期而言, 受全球性新冠疫情和国际贸易摩擦影响, 使得国外对中国电子产品的需求量大幅上升, 而国内企业布局国产化安全供应链逐步成为趋势, 再加上前几年半导体行业的投资偏少、国内产业技术层面需要提升等因素, 导致目前市场上半导体器件的供需紧张。从需求的持续性趋势和投资的滞后周期来看, 目前这样的缺货情况估计还会延续到明年。</p> <p>Q: 今年以来的产品涨价情况 A: 由于原材料的上涨幅度太大了, 所以除了供应链和公司自身想办法消化部分外, 公司也只能通过产品销格调整来转化部分。公司总体的策略是立足于长远的可持续性发展, 没有趁势大幅度涨价去追求短期利益, 而是通过技术进步来推进产品结构调整和客户结构的调整。公司今年的毛利率水平稳定, 并有小幅提升。</p> <p>Q: 目前的产能利用和扩张情况, 募投项目实施情况 A: 在晶圆方面, 公司自有一条 5/6 寸平面芯片线和一条 4 寸台面芯片线, 主要生产功率半导体二极管芯片, 全部用于自配。自制芯片占公司芯片总需求的比例在 20%-25%。小信号芯片和光电器件芯片全面外购。除了自制晶圆再扩产一部分外, 针对目前市场上 MOSFET 和 SKY 芯片十分紧张的形势, 公司也在强化外部芯片制定点的供应链布局和管控工作, 以确保公司长期的竞争能力。 在封测方面, 公司主要以自主品牌为客户提供产品, 相对于目前的订单需求, 公司主要产能瓶颈在封装。公司积极推进募投扩产项目的建设, 募投项目总体计划提升贴片产品的封装产能 50%以上, 完全达产周期为 2-3 年。</p> <p>Q: 客户及应用市场的发展规划 A: 公司的客户主要以消费类电器产品为主, 今年电脑周边产品, 如显示器、主板、风扇、路由器、POS 机等增长较快, 工控类和汽车电子也是公司后续要着力拓展的领域。 目前小信号器件是公司的核心业务, 我们将进一步做强做大, 并充分利用功率二极管芯片自研能力, 扩大功率器件的销售。未来公司还将加强封装技术的研究和布局, 重点围绕 SiP、CSP 等先进封装技术和 SiC SBD 等第三代半导体的应用, 不断提升公司的核心技术</p>

	能力。
附件清单 (如有)	无
日期	2021年7月3日